

注意事項

- 1.使用限制:本機台屬半導體製程前段機台，晶圓傳輸機構為非接觸吸附式，僅能使用 8 吋矽晶圓基板，無法適用其它尺寸晶圓或破片基材。本機台為薄膜磊晶，氣體和腔體都要達到原子級潔淨度，因此目前僅開放未經過其它製程或僅有經過前段熱氧化製程之晶圓基板。經過後段製程或任何金屬製程者皆嚴格禁止使用。
- 2.非標準製程務必與機台負責人連絡討論可行性，欲送件前如有任何問題請與機台負責人連絡。
3. 磊晶前晶圓之清洗必須在 NDL wet-bench 完成。